

## RESICHEM 510 MCU 126 –

### 单组份，吸水固化底胶，长再次涂覆时间

Resichem 510 MCU 126 产品为溶剂型，聚酯型底胶（单组份），产品再次涂覆窗口长达7天。底胶吸水固化，可涂覆于含旧涂层及金属表面。同时可与任何Resimac聚氨酯涂层及抗紫外线涂层搭配使用。

- 单组份
- 吸水固化
- 7天内可再次涂覆

### 主要应用

钢铁结构

金属楼梯

罐体外表面

### 表面处理

#### 金属基材-机械打磨

1. 所有表面使用角磨机机械打磨处理至 **ISO 8501/4 ST3 (SSPC SP3 ST3)** 光洁度。
2. 打磨处理后，所有表面油污及油脂必须使用丙酮等适当清洁剂清除。
3. 处理后的表面应在氧化及还原反应发生前进行涂覆。

#### 金属基材 - 高压冲洗

1. 使用 12,000 psi (850bar) 高压水进行高压冲洗至 **NACE 5 (SSPC SP13 WJ3-WJ1)** 表面处理标准。
2. 处理后的表面应在氧化及还原反应发生前进行涂覆。

#### 金属基材 - 喷砂处理

1. 所有表面经喷砂处理至 **ISO 8501/4 Standard SA2.5 (SSPC SP10/ NACE 2)** 表面光洁度及至少75 微米的粗糙度。
2. 喷砂处理后，所有表面油污及油脂必须使用丙酮等适当清洁剂清除。
3. 处理后的表面应在氧化及还原反应发生前涂覆。

**注意：**所有受盐分污染的表面需使用高压水反复冲洗至盐分检测达到施工标准时停止，具体请参照表面处理指南建议。

### 混合

混合前，请确保满足以下条件：

1. 产品温度达到15-25°C (60-77F°) 之间。
2. 环境 & 基材表面温度高于 10°C (50F°)。

满足以上要求后，开始产品混合

1. 使用电动搅拌器，简单搅拌混合产品。

### 施工

#### 刷涂或辊涂施工

1. 使用50mm宽毛刷，首先刷涂角落，接缝等特殊区域。
2. 待特殊区域刷涂的产品固化后，按100微米湿膜厚度进行整体刷涂。

#### 喷涂施工

1. 喷涂施工应使用泵比为45:1喷涂机。
2. 喷涂压力为2500psi及使用的喷嘴尺寸为11-13 thou。
3. 按100微米湿膜厚度涂覆产品至处理后的基材表面。

## 覆盖率

5升 完全混合后的产品有以下固化时间 –

100 微米下为 50 m<sup>2</sup>

*注意：以上数值为理论数据。*

## 固化时间

在20°C (68°F)下涂覆的产品有以下固化时间，时间随温度成正比：

触干 2 小时

最短再次涂覆时间 4 小时

最长再次涂覆时间 7 天

## 包装尺寸

产品有以下包装尺寸 – 5升

## 颜色

单组份 – 灰色

## 储存时限

常温(15-30°C/ 60-86°F)，干燥，未开封下为 2年

## Other Technical Documents

Safety Data Sheets - Single component

## Health and Safety

Please ensure good practice is observed at all times. Protective gloves, goggles & a disposable coverall must be worn during the mixing and application of this product. Before mixing and applying the material ensure you have read the fully detailed Safety Data Sheet.

## Legal Notice:

The data contained within this Technical Data Sheet is furnished for information only and is believed to be reliable at the time of issue. We cannot assume responsibility for results obtained by others over whose methods we have no control. It is the responsibility of the customer to determine if the product is suitable for use. Resimac accepts no liability arising out of the use of this information or the product described herein.